

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种高密度电路板中微细盲孔的铜电镀填充方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

2

下载

0

收藏

0

作者 祝清省、祝汉品、崔学顺、张贤

发表日期 2019-10-22

专利号 201610265605.2

著作权人 祝清省、祝汉品、崔学顺、张贤

国家 中国

文献子类 发明专利

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/158451>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

作者单位 中国科学院金属研究所

推荐引用方式 祝清省、祝汉品、崔学顺、张贤. 一种高密度电路板中微细盲孔的铜电镀填充方法.

GB/T 7714 201610265605.2. 2019-10-22.

[其他版本](#)

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

[欧盟学术资源开放存取平台](#) | [CALIS高校机构知识库](#) | [台湾学术机构典藏](#) | [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

[0931-8270076](#) 发送邮件

陇ICP备2021001824
号-8

甘公网安备 62010202001088号